

第 13 回 有機/無機接合研究委員会

日時：2022 年 6 月 28 日（火） 13:00～16:05

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 浅井 竜彦（富士電機(株)）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『自動車電動化に向けた高耐熱脂環式エポキシ樹脂の開発』（40 分）

..... ○竹中 洋登、鈴木 弘世（(株)ダイセル）

13:50～14:30

『実装信頼性を向上させる高性能樹脂強化型はんだ材料の開発』（40 分）

..... ○五十井 浩平^{*1}、日野 裕久^{*1}、坂口 茂樹^{*1}、松野 行壮^{*1}、山津 繁^{*2}
（^{*1}パナソニックホールディングス(株)、^{*2}パナソニックインダストリー(株)）

14:30～14:45 休憩

司会 鈴木 孝明（群馬大学）

14:45～15:25

『インプリント技術を用いた基板配線形成』（40 分）

.....○小松 裕司、酒井 大介、下石坂 望（コネクテックジャパン(株)）

15:25～16:05

『メッキによる異種接合』（40 分）

.....○馬淵 守、袴田 昌高（京都大学）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会